

# Chemicals contained in products

## Package-type

Epson Package name; **PLP063031A-10PIN / Halogen free**

JEITA Package name; **(P-UPLP010-03.10x03.00-0.50)**

Weight; **0.012 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content *Note2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	0.40	シリコン	7440-21-3	0.40	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.000001	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.000002	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.00001	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.000002	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.000001	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.00001	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.00001	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.00001	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.000001	2	配線材
パッケージ	保護膜	0.008	ポリイミド	-	0.008	1000000	保護膜 ※4
	ダイアタッチ材	0.14	銀	7440-22-4	0.10	750000	主成分
			エポキシ樹脂	-	0.027	200000	接着剤
			フェノール樹脂	-	0.007	50000	接着剤
	基板	1.2	金	7440-57-5	0.023	19486	主成分
			ニッケル	7440-02-0	1.2	980514	主成分
	ボンディングワイヤー	0.07	金	7440-57-5	0.073	1000000	主成分
	封止材	10.2	エポキシ樹脂	-	0.51	49954	主成分
			フェノール樹脂	-	0.46	44959	硬化剤
			溶融シリカ	60676-86-0	8.9	867163	充填材
			有機リン化合物	-	0.051	4995	硬化促進剤
			カーボンブラック	1333-86-4	0.030	2956	着色剤
			金属水酸化物	-	0.31	29972	難燃剤

### 化学物質の情報について

※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。

※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。

従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。

※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。

※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。